Semicon 參展摘要

Semicon 2026–Day2

重點摘要

1. 2026 Semicon 和以往不同之處在（1）設備廠商的客戶更多元分散，不同於過去都集中在台灣主要的晶圓代工客戶，今年 OSAT 廠商的拉貨力道強勁，並且 US IDM 廠，記憶體廠甚至德州的 Terafab 台廠都陸續有新的進展和機台送驗、（2）CPO、FOPLP 的相關設備，解決生產瓶頸（例如：翹曲、溫控）的解決方案更勝往年、以及（3）數家設備廠商都有提到導入 AI agent 對於設計和解決方案的優化。
2. 半導體展的核心是設備，雖然 KLA 和 TEL 等前端設備國際大廠有參展，但是圍繞先進封裝、測試和耗材的參展廠商仍佔了 90%。而設備的關鍵就在新技術的導入以及解決目前的生產瓶頸。凱基 9/3 採訪了群翊、中華精測、G2C+的志聖、均華、東捷和均豪、中砂、新應材、鈺祥、鴻勁。而我們的觀察基於這兩天參訪的結論，不僅限於我們參訪的公司。
3. CoWoS、3D 封裝、面板級封裝以及 CPO 相關的設備仍然是展出的主旋律。CPO 和 TGV（玻璃通孔技術）的解決方案較往年大幅增加，因為在導入玻璃材質以及光學精度兩大領域的物理極限都是進入門檻。儘管市場上對於晶片升級或是降規的傳言不斷，這並不影響目前設備的升級和拉貨，部分設備的 lead-time 已經從 6-9 個月延伸到了 9-12 個月。在晶圓代工和封裝測試業者持續提高資本支出的情況下，我們看好設備和耗材持續受惠於晶片設計複雜化以及客戶大幅擴產的趨勢。以我們覆蓋的公司來說，我們持續看好測試介面的精測、穎崴、旺矽，測試設備的鴻勁，封裝設備的志聖以及鑽石碟的中砂。

凱基投顧

潘俊宏
886.2.2181.8706
Felix.Pan@kgi.com

劉宇程
886.2.2181.8727
lucas.liu@kgi.com

許芝瑄
886.2.2181.8016
Serena.Hsu@kgi.com

張育程
886.2.2181.8735
eden.chang@kgi.com

王婉懿
886.2.2181.8715
vera.wy.wang@kgi.com

重要免責聲明，詳見最終頁

群翊 (6664 TT，NT$363，未評等)

- 群翊主要提供半導體及 PCB 製程設備，產品涵蓋 RGV 自動烘烤、真空壓膜、內層滾輪塗布及視覺軟體整合系統。公司由烘烤、壓膜及塗布等單站設備，逐步延伸至 all-in-one 整線方案，並在美國鳳凰城與重要 IDM 客戶合作超過 10 年，目前於德州及鳳凰城均設有服務據點。
- 公司此次展出重點為 RGV 自動烘烤系統及真空壓膜機，其中 RGV 系統以大型機械手臂進行自動搬送，各烘烤腔體可獨立控制升溫、多段溫度及降溫條件；真空壓膜機則用於乾膜貼合，可降低氣泡、空隙及貼合不均問題，相關專利已布局台灣、美國、日本及韓國，並已導入國內大型封裝客戶。
- 受惠 AI 晶片及封裝尺寸放大、線路密度提高與製程複雜度增加，先進封裝對乾膜貼合均勻性、無氣泡製程及烘烤溫控精度的要求同步提升，帶動真空壓膜、自動化烘烤、塗布及視覺整合設備需求。公司表示 2026 年訂單已滿、2027 年基本滿單，目前已開始觀察 2028 年後需求，並規劃興建楊梅二廠及將集團人力由約 400 人擴充至 600 人，以因應後續產能與研發需求。

圖 1：群翊提供浸泡式塗佈設備



資料來源：群翊；凱基

圖 2：群翊提供塗佈、乾燥、壓膜製程設備



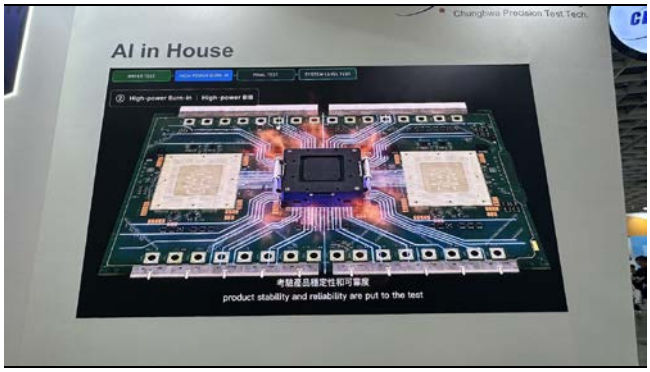
資料來源：群翊；凱基

精測 (6510 TT，NT$3,350，增加持股)

- 精測為全球半導體測試介面領導廠商，核心產品包括探針卡、探針卡 PCB 及 IC 載板，主要應用於智慧型手機、AI/HPC、網通及車用晶片等。
- 此次半導體展，精測展出各類探針卡 PCB、IC 載板。公司優勢為從設計、研發到生產皆是 all in house，減少與外部供應商之溝通落差及錯誤產生，並提高產品交付速度

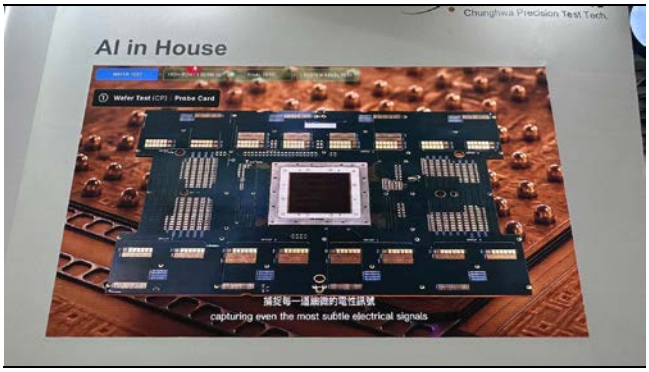
- 展望中長期，精測將受惠 GPU 與 ASIC 等多項 AI 專案挹注，且公司提供之產品涵蓋完整測試流程，包括晶圓級測試、最終測試、系統級測試及老化測試。公司預期 2027 年 ASIC 業務比重將有望超越 GPU，成為下一階段主要成長動能。爲因應客戶需求，精測 8 月底整體產能已較 2025 年底倍增，預計 2027 年上半年再增加 50%，且後續將持續擴充，顯示需求極爲強勁。

圖 3：精測提供 High-power Burn-in 測試方案



資料來源：精測；凱基

圖 4：精測展示 Probe Card 技術能力



資料來源：精測；凱基

志聖 (2467 TT，NT$595，增加持股)

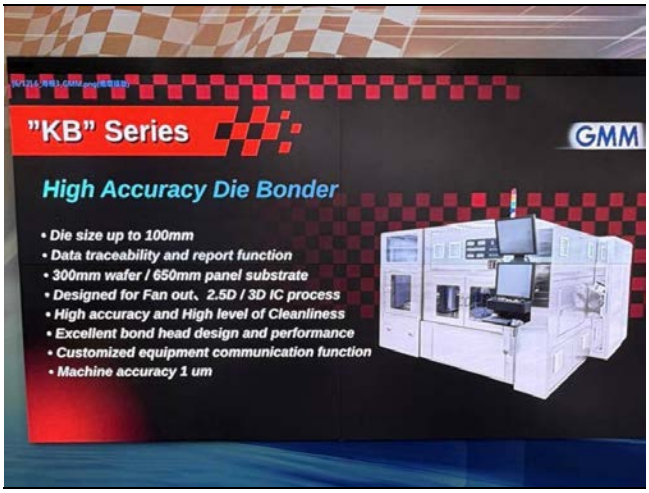
- G2C 聯盟：成員包括志聖（2467 TT，增加持股）、均豪(5443 TT，NT$110，未評等)、均華(6640 TT，NT$1,185，未評等)以及新加入的東捷（8064 TT，未評等）。志聖聚焦烘烤設備、壓膜/撕膜、晶圓 bonder 設備（撕、貼、烤、壓），均豪布局 AOI、精密量測、Grinding、CMP 等檢測及製程設備，均華專注精密取放包括高精度 Die Bonder、Inspection Sorter 等晶粒貼合與分選設備，整體應用涵蓋 CoWoS、FoPLP、Fan-out 及 2.5D/3D IC 等先進封裝製程。
- 本次 Semicon 志聖展示 De-Warpage Oven、Wafer ABF Laminator、真空壓膜及電漿去除光阻等設備，其中 De-Warpage Oven 翹曲公差可控制於≤3 mm，均豪展示 Carrier AOI、Strip Grinder 及 CMP，其中 Strip Grinder 支援最大 195 × 240 mm 產品、研磨後 TTV ≤5 μm，均華則展示 KB Series Die Bonder，支援 300 mm wafer/650 mm panel substrate、設備精度達 1 μm，並搭配 KS Series 多面及 IR Inspection Sorter。G2C 聯盟的綜效除了核心的四家公司以外，也透過樂林科技代理了數家公司的關鍵設備和耗材，進一步擴大聯盟的縱深。
- AI/HPC 晶片大型化、CoWoS 持續擴產及 FoPLP 等大尺寸封裝架構發展，將提升翹曲控制、精密量測、Grinding/CMP 及 Die Bond 等設備需求，志聖將續受惠熱製程及翹曲控制需求，均豪由 AOI/自動化延伸至高階量測及研磨設備，均華則受惠 Die Bonder 與 Inspection Sorter 規格升級。公司看好在主要晶圓代工以及封測客戶持續拉高資本支出的趨勢下，結合設備在地化趨勢，業務持續伴隨客戶擴產和設備升級而成長。

圖 5：志聖 De-Warpage Oven 應用於先進封裝翹曲控制



資料來源：志聖；凱基

圖 6：均華高精度 Die Bonder 支援大尺寸先進封裝

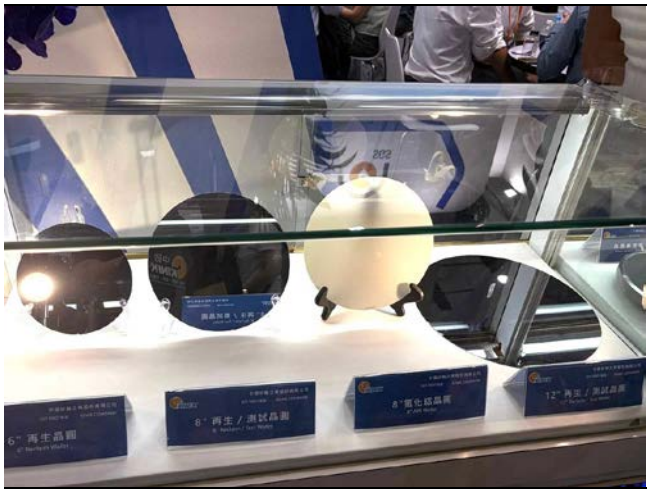


資料來源：均華；凱基

中砂 (1560 TT，NT$711，增加持股)

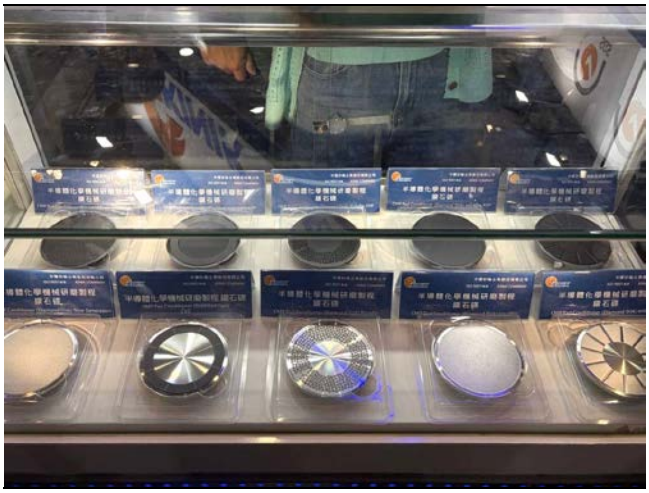
- 中砂主要產品涵蓋鑽石砂輪、CMP 鑽石碟及再生/測試晶圓，其中鑽石碟主要用於修整 CMP polishing pad，SBU 則提供再生晶圓、test wafer 及特殊晶圓，具備研磨、拋光、清洗及檢測等一站式加工能力。
- 本次展出重點聚焦先進製程及先進封裝應用，包括已切入 1.4nm/A14 的新一代 CMP 鑽石碟、SiC/GaN 等特殊晶圓，以及 CoWoS、3DIC、HBM、hybrid bonding 所需的高階研磨砂輪。
- 先進製程微縮及先進封裝發展可望持續推升 CMP 與研磨耗材需求，CMP layer 隨製程演進持續增加，晶背供電可望額外增加 20-25% CMP 道數，目前 3nm/2nm 鑽石碟市占率已達 70-80%，1.4nm 亦已開始出貨。

圖 7：中砂再生/測試晶圓及特殊材料晶圓



資料來源：中砂；凱基

圖 8：中砂 CMP 鑽石碟產品

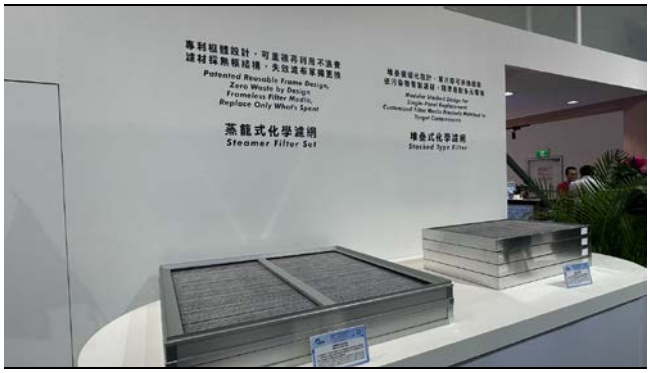


資料來源：中砂；凱基

鈺祥 (7909 TT，NT$624，未評等)

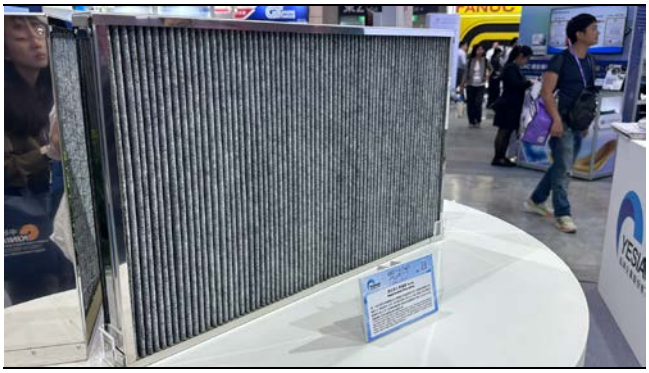
- 鈺祥為台灣主要空氣濾網製造商，深耕於半導體空氣過濾與潔淨環境領域，主要產品包含濾網(FFU)及濾筒(MAU)以提供 AMC 解決方案。濾筒主要負責處理從外部進入室內的大量空氣；濾網則過濾無塵室環境中的微量有害氣體。
- 此次半導體展，鈺祥展出各類型濾筒、一次性濾網、再生型濾網、液體濾網等產品。其中，再生濾網已於 2Q26 通過主要客戶認證並開始出貨，預期既有客戶廠區出貨量將持續成長並新增廠區導入再生濾網；液體濾網已進入認證階段，公司目標於 2027 年產生營收貢獻。
- 展望晶圓代工與先進封裝廠導入微汙染防治，帶動化學濾網需求量倍數增加。同時，隨先進製程新建廠數量與客戶資本支出逐年成長，公司目標 2028 年整體營收將達 2025 年既有業務的 5.4 倍，並預估未來至少具有高達 20 座先進製程新廠擴建的微污染防治需求。此外，公司目標長期再生濾網營收佔比達 50%以上，有望帶動毛利率及獲利持續成長。

圖 9：鈺祥提供多元 AMC 解決方案



資料來源：鈺祥；凱基

圖 10：鈺祥展示再生濾網產品



資料來源：鈺祥；凱基

新應材 (4749 TT，NT$759，持有)

- 新應材高度聚焦於半導體前段製程材料開發，半導體材料佔營收比重高達 90%。公司具備合成、純化到配方的一條龍能力，有助縮短客戶產品開發時程。目前新應材的 BARC（底部抗反射塗層）及關鍵添加劑已全面實現自研自產。
- 公司表示 DUV 光阻開發進度順利，儘管先進製程逐步導入 EUV，但單片晶圓約 80-100 道曝光中，EUV 僅約 20 道，其餘仍以 DUV 為主，因此 DUV 光阻需求量仍顯著高於 EUV。先進封裝方面，則透過昱鐳應材及新竇紘布局先進封裝所需膠材與高階膠帶。
- 公司長期仍將研發資源集中於前段製程材料，主因主要晶圓代工客戶前段製程產能為先進封裝的 10 倍以上（150 萬片 vs 12 萬片），且先進製程黃光微影道數多達 80-85 道以上，亦遠高於先進封裝約 5-10 層 RDL。此外，前段材料導入後可延續使用數十年，產品生命週期明顯優於約五年即可能隨封裝技術更替的後段材料，具備較高進入門檻及長期營收累積效果。

圖 11：新應材先進半導體光阻產品布局



資料來源：新應材；凱基

圖 12：新應材黃光微影周邊清洗材料布局



資料來源：新應材；凱基

鴻勁 (7769 TT，NT$5,870，增加持股)

- 鴻勁主要提供封裝後測試 Handler 與 ATC 溫控整合方案，涵蓋 FT、SLT 等測試，目前 FT/SLT 全球累計裝機量超過 3 萬台，鴻勁 FT 在 AI/HPC/ASIC 等高階市場市佔率 70%，SLT 不分終端的市佔率為 50%。
- 本次展出重點為高階溫控、Large Package Handler 與 CPO 光電同測方案，ATC 搭配 Cold Plate 可動態控制高功耗晶片測試溫度，而 Cold Plate 需隨產品世代客製化更換，隨 Package 尺寸放大，既有載盤與 Handler 無法支援，亦帶動 Large Package 新機需求。
- 前瞻 CPO 應用，公司規劃將現行光測、電測兩道流程整合至同一 Handler，光電同測需採用全新 Handler，內有光學對位及量測模組，設備複雜度與單價均較高，鴻勁預計 10 月推出量產型驗證機，雖然客戶的最終規格未定，但目前設備開發進度並沒有延遲，後續希望可藉由 insertion 4 產品優勢進一步的延伸至 Insertion 3 的解決方案。

圖 13：鴻勁 HT-503M 實驗型 Handler 與 ATC



資料來源：鴻勁；凱基

圖 14：鴻勁 CPO 光電同測解決方案



資料來源：鴻勁；凱基

凱基證券集團據點

中國	上海	上海市靜安區南京西路 1601 號越洋國際廣場 1507 室 郵政編號：200040
台灣	台北	104 台北市明水路 700 號 電話 886.2.2181.8888·傳真 886.2.8501.1691
香港		香港灣仔港灣道十八號中環廣場四十一樓 電話 852.2878.6888·傳真 852.2878.6800
泰國	曼谷	8th - 11th floors, Asia Centre Building 173 South Sathorn Road, Bangkok 10120, Thailand 電話 66.2658.8888·傳真 66.2658.8014
新加坡		珊頓大道 4 號#13-01 新交所第二大廈 郵政編號：068807 電話 65.6202.1188·傳真 65.6534.4826
印尼		Sona Topas Tower Fl.11 Jl. Jend. Sudirman kav.26 JakartaSelatan 12920 Indonesia 電話 62 21 250 6337

股價說明

等級	**定義**
未評等 (OP)	對個股持正面看法，預期個股未來十二個月的表現超越凱基證券集團所追蹤的相關市場的總報酬。
持有 (N)	對個股持中性看法，預期個股未來十二個月的表現符合凱基證券集團所追蹤的相關市場的總報酬。
降低持股 (U)	對個股持負面看法，預期個股未來十二個月的表現低於凱基證券集團所追蹤的相關市場的總報酬。
未評等 (NR)	凱基證券未對該個股加以評等。
受法規限制未評等 (R)	受凱基證券集團內部政策和/或相關法令限制使凱基證券集團無法進行某些形式的資訊交流，其中包括提供評等給投資人參考。
	*總報酬 = (十二個月目標價-現價)/現價

免責聲明

凱基證券投資顧問股份有限公司（以下簡稱本公司）為凱基金控集團之成員。本報告之內容皆來自本公司認可之資料來源，但不保證其完整性及精確性。報告內容所提及之各項業務、財務等相關檔案資料及所有的意見及預估皆基於本公司於特定日期所做之判斷，故有其時效性限制，遷後若有變更時，本公司將不做預告或更新。本報告內容僅供參考，並不提供或遊說客戶為買賣股票之投資依據。投資人應審慎考量本身之投資風險，並就投資結果自行負責。本公司及所屬集團成員，暨其主管或員工皆有可能持有報告中所提及的證券。本公司及所屬集團成員並可能經常提供投資銀行或其他服務給報告中提及之公司或向其爭取相關業務。本報告之著作權為本公司所有，非經本公司同意，本報告全文或部份內容，不得以任何形式或方式引用、轉載或轉寄。